

NI PXI/PCI-6551/6552 Specifications

50/100 MHz Digital Waveform Generator/Analyzer

このドキュメントには、日本語ページも含まれています。

This document provides the specifications for the NI PXI/PCI-6551 (NI 6551) and the NI PXI/PCI-6552 (NI 6552).

Typical values are representative of an average unit operating at room temperature. Specifications are subject to change without notice. For the most recent NI 6551/6552 specifications, visit ni.com/manuals.

To access the NI 6551/6552 documentation, including the *NI Digital Waveform Generator/Analyzer Getting Started Guide*, which contains functional descriptions of the NI 6551/6552 signals, navigate to **Start» Programs»National Instruments»NI-HSDIO»Documentation**.



Hot Surface If the NI 6551/6552 has been in use, it may exceed safe handling temperatures and cause burns. Allow time to cool before removing it from the chassis.



Note All values were obtained using a 1 meter cable (SHC68-C68-D4 recommended). Performance specifications are not guaranteed when using longer cables.

Contents

Channel Specifications	3
Generation Channels (Data, DDC CLK OUT, and PFI <0..3>)	4
Acquisition Channels (Data, STROBE, and PFI <0..3>)	5
Hardware Comparison	6
Timing Specifications	7
Sample Clock	7
Generation Timing (Data, DDC CLK OUT, and PFI <0..3> Channels)	8
Acquisition Timing (Data, STROBE, and PFI <0..3> Channels)	10
CLK IN (SMB Jack Connector)	13
STROBE (DDC Connector)	15
PXI_STAR (PXI Backplane—PXI only)	15
CLK OUT (SMB Jack Connector)	16
DDC CLK OUT (DDC Connector)	16
Reference Clock (PLL)	17
Waveform Characteristics	17
Memory and Scripting	17
Triggers (Inputs to the NI 6551/6552)	20
Events (Output from the NI 6551/6552)	22
Calibration	23
Power	23
Software Specifications	24
Environment	24
Safety, Electromagnetic Compatibility, and CE Compliance	26
Physical Specifications	28

Channel Specifications

Specification	Value	Comments
Number of data channels	20	—
Direction control of data channels	Per channel, per cycle, bidirectional	—
Number of programmable function interface (PFI) channels	4	Refer to the Waveform Characteristics section for more details.
Direction control of PFI channels	Per channel	—
Number of clock terminals	3 input 2 output	Refer to the Timing Specifications section for more details.

Generation Channels (Data, DDC CLK OUT, and PFI <0..3>)

Specification	Value	Comments
Generation voltage range	–2.0 V to 5.5 V	Into 1 M Ω
Generation signal type	Single-ended	—
Number of programmable voltage levels	1 voltage low level 1 voltage high level Note: While you can only set one voltage low level and one voltage high level for all generation channels, you can set a different voltage low level and voltage high level for all acquisition channels. You can also set the channels to the high-impedance state (tristate).	For all data, CLK OUT (Sample clock only), and PFI channels
Generation voltage range restrictions	–0.5 V to 5.5 V (up to 50 MHz clock rate) –2.0 V to 3.7 V (up to 50 MHz clock rate) –0.5 V to 3.7 V (50 MHz to 100 MHz clock rate; NI 6552 only)	Into 1 M Ω
Generation voltage swing	400 mV to 6 V (up to 50 MHz clock rate) 400 mV to 4.2 V (50 MHz to 100 MHz clock rate; NI 6552 only)	Into 1 M Ω
Generation voltage level resolution	10 mV	Into 1 M Ω
DC generation voltage level accuracy	± 20 mV	Into 1 M Ω ; does not include system crosstalk
Output impedance	50 Ω nominal	At 25 °C
Output impedance temperature coefficient	0.2 Ω /°C	Typical
Maximum DC drive strength	± 50 mA maximum per channel ± 600 mA maximum for all data, clock, and PFI channels	—

Specification	Value		Comments
Data channel driver enable/disable control	Per channel per cycle		—
Channel power-on state	Module Assemblies Labeled A and B	Module Assemblies Labeled C and Later	—
	Drivers disabled, 10 k Ω input impedance	Drivers disabled, 50 k Ω input impedance	
Output protection	The device can indefinitely sustain a short to any voltage in the generation voltage range.		—

Acquisition Channels (Data, STROBE, and PFI <0..3>)

Specification	Value	Comments
Number of voltage comparators per channel	2	—
Acquisition voltage range	–2.0 V to 5.5 V	—
Number of programmable acquisition thresholds	1 voltage low threshold 1 voltage high threshold Note: While you can set only one voltage low level and one voltage high level for all acquisition channels, you can set a different voltage low level and voltage high level for all generation channels. You can also set the channels to the high-impedance state (tristate).	For all data, STROBE, and PFI channels
Minimum detectable voltage swing	50 mV	10 k Ω input impedance, measured with 50% duty cycle input signal
Acquisition voltage threshold resolution	10 mV	10 k Ω input impedance

Specification	Value		Comments
DC acquisition voltage threshold accuracy	± 30 mV		10 k Ω input impedance, does not include system crosstalk
Input impedance	Module Assemblies Labeled A and B	Module Assemblies Labeled C and Later	Software-selectable per channel when powered on and within valid voltage range.
	50 Ω nominal or 10 k Ω (default)	50 Ω nominal or 50 k Ω (default)	
Input protection	–2.3 V to 6.8 V		Diode clamps in the design may provide additional protection outside this range.

Hardware Comparison

Specification	Value		Comments
Error FIFO depth	4,094		For information about fetching error data, refer to the <i>NI Digital Waveform Generator/Analyzer Help</i> .
Number of repeated errors	255		—
Speed (maximum)	NI 6551: 50 MHz NI 6552: 100 MHz		—

Timing Specifications

Sample Clock

Specification	Value	Comments
Sample clock sources	<ol style="list-style-type: none"> 1. On Board Clock (internal voltage-controlled crystal oscillator (VCXO) with divider) 2. CLK IN (SMB jack connector) 3. PXI_STAR (PXI backplane—PXI only) 4. STROBE (DDC connector; acquisition only) 	—
On Board Clock frequency range	NI 6551: 48 Hz to 50 MHz Configurable to 200 MHz/ N , where $4 \leq N \leq 4,194,304$ NI 6552: 48 Hz to 100 MHz Configurable to 200 MHz/ N , where $2 \leq N \leq 4,194,304$	—
CLK IN frequency range	NI 6551: 20 kHz to 50 MHz NI 6552: 20 kHz to 100 MHz	Refer to the CLK IN (SMB Jack Connector) section for restrictions based on waveform type.
PXI_STAR frequency range (PXI only)	NI 6551: 48 Hz to 50 MHz NI 6552: 48 Hz to 100 MHz	Refer to the PXI_STAR (PXI Backplane—PXI only) section.
STROBE frequency range	NI 6551: 48 Hz to 50 MHz NI 6552: 48 Hz to 100 MHz	Refer to the STROBE (DDC Connector) section.
Sample clock relative delay adjustment	0.0 to 1.0 Sample clock periods	You can apply a delay or phase adjustment to the On Board Clock to align multiple devices.
Sample clock relative delay adjustment resolution	10 ps	

Specification	Value		Comments
Exported Sample clock destinations	1. DDC CLK OUT (DDC connector) 2. CLK OUT (SMB jack connector)		Sample clocks with sources other than STROBE can be exported.
Exported Sample clock delay range (δ_C)	0.0 to 1.0 Sample clock periods		For clock frequencies ≥ 25 MHz
Exported Sample clock delay resolution (δ_C)	1/256 of Sample clock period		For clock frequencies ≥ 25 MHz
Exported Sample clock jitter	Period Jitter	Cycle-to-Cycle Jitter	Typical; using On Board Clock
	20 ps _{rms}	35 ps _{rms}	

Generation Timing (Data, DDC CLK OUT, and PFI <0..3> Channels)

Specification	Value		Comments
Data channel-to- channel skew	Typical	Maximum	Across all channels
	± 300 ps	± 900 ps	
Maximum data channel toggle rate	NI 6551: 25 MHz NI 6552: 50 MHz		—
Data formats	Non-return to zero (NRZ)		—
Data position modes	Sample Clock Rising Edge, Sample Clock Falling Edge, or Delay from Sample Clock Rising Edge		Per channel
Generation data delay range (δ_G)	0.0 to 1.0 Sample clock periods		Supported for clock frequencies ≥ 25 MHz
Generation data delay resolution (δ_G)	1/256 of Sample clock period		Supported for clock frequencies ≥ 25 MHz

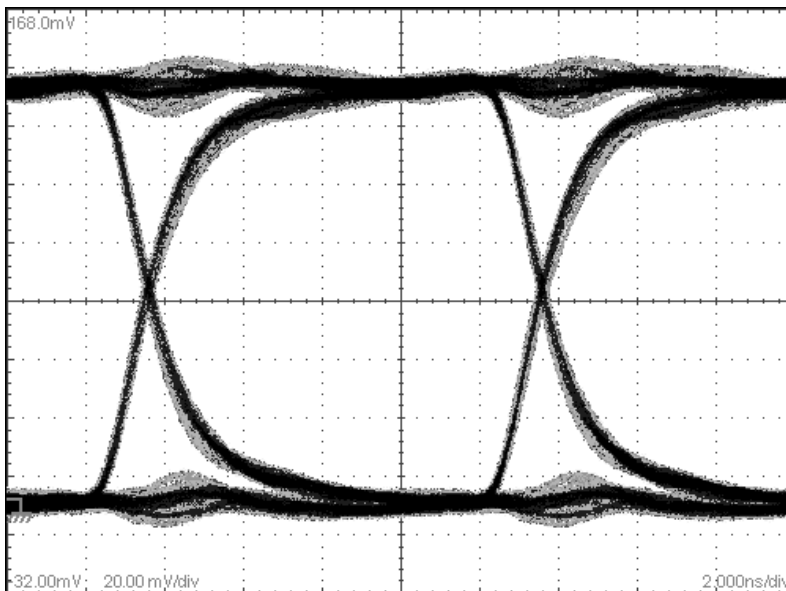


Figure 1. Eye Diagram¹

Specification	Value		Comments
Rise time (0 V to 3.3 V swing)	Into 50 Ω	Into 1 MΩ	20% to 80%, typical
	2.25 ns	2.75 ns into 475 pF test system capacitance	
Fall time (0 V to 3.3 V swing)	2.25 ns	2.75 ns into 475 pF test system capacitance	20% to 80%, typical
Exported Sample clock offset (t_{CO})	0 ns or 2.5 ns (default)		Software-selectable
Time delay from Sample clock (internal) to DDC connector (t_{SCDDC})	32.5 ns		Typical

¹ This eye diagram was captured on DIO 0 (100 MHz clock rate) at 3.3 V at room temperature into 50 Ω termination.

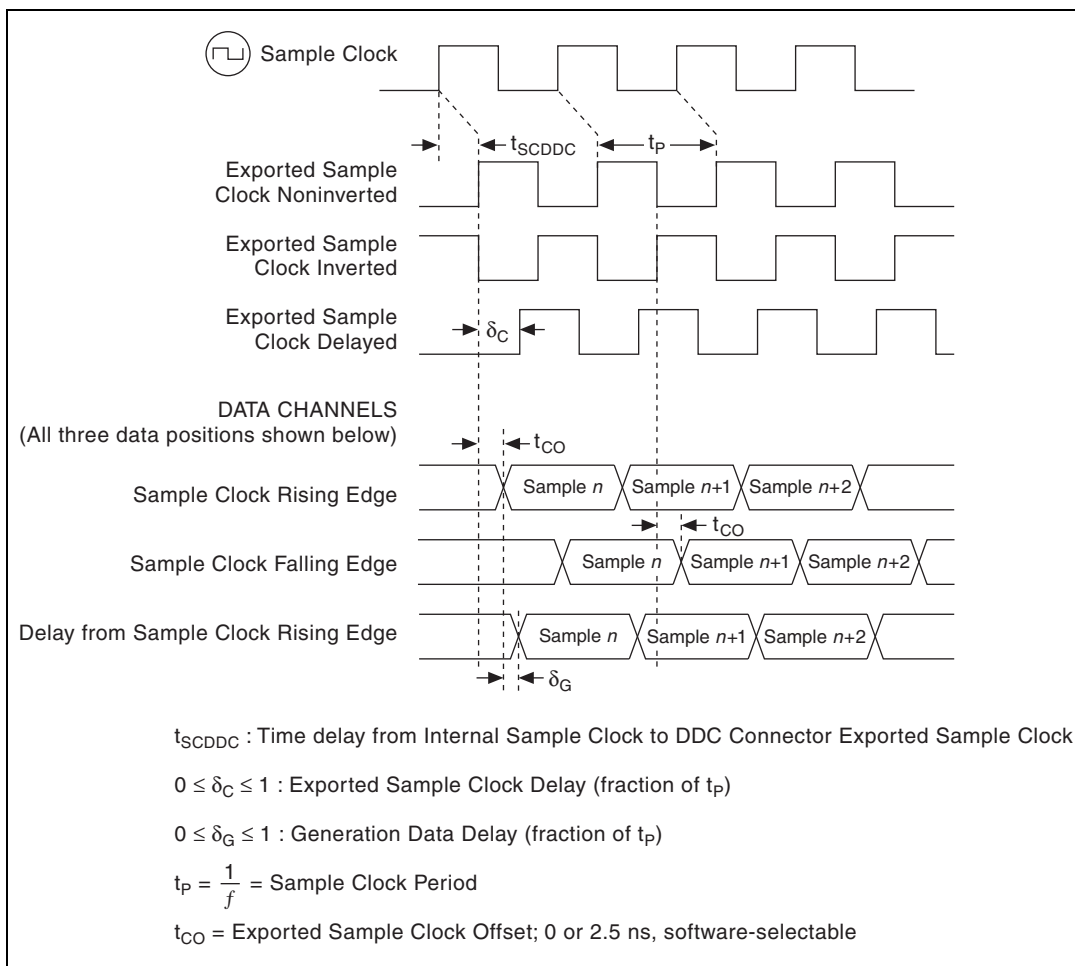


Figure 2. Generation Timing Diagram

Acquisition Timing (Data, STROBE, and PFI <0..3> Channels)

Specification	Value		Comments
Data channel-to-channel skew	Typical	Maximum	Across all channels
	± 400 ps	± 900 ps	
Minimum detectable pulse width	4 ns		Required at both acquisition voltage thresholds

Specification	Value	Comments
Set-up time to STROBE (t_{SUS})	2.3 ns	Maximum; includes maximum data channel-to-channel skew
Hold time to STROBE (t_{HS})	1.9 ns	Maximum; includes maximum data channel-to-channel skew
Time delay from DDC connector to internal Sample clock (t_{DDCSC})	27.5 ns	Typical
Set-up time to Sample clock (t_{SUSC})	0.4 ns	Does not include data channel-to-channel skew, t_{DDCSC} , or t_{SCDDC}
Hold time to Sample clock (t_{HSC})	0 ns	Does not include data channel-to-channel skew, t_{DDCSC} , or t_{SCDDC}
Data position modes	Sample Clock Rising Edge, Sample Clock Falling Edge, or Delay from Sample Clock Rising Edge	Per channel
Acquisition data delay range (δ_A)	0.0 to 1.0 Sample clock periods	For clock frequencies ≥ 25 MHz
Acquisition data delay resolution (δ_A)	1/256 of Sample clock period	For clock frequencies ≥ 25 MHz

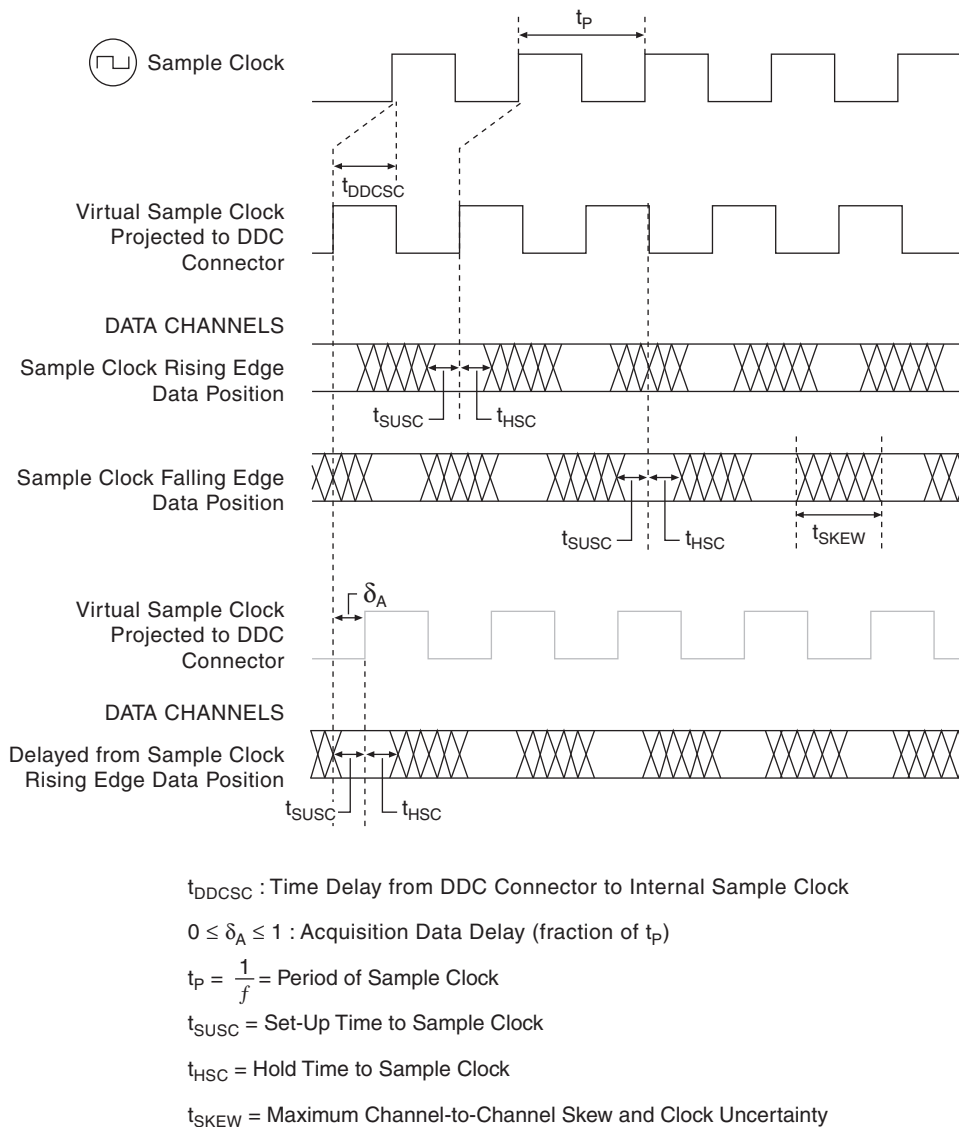


Figure 3. Acquisition Timing Diagram



Note Provided set-up and hold times account for maximum channel-to-channel skew and jitter.

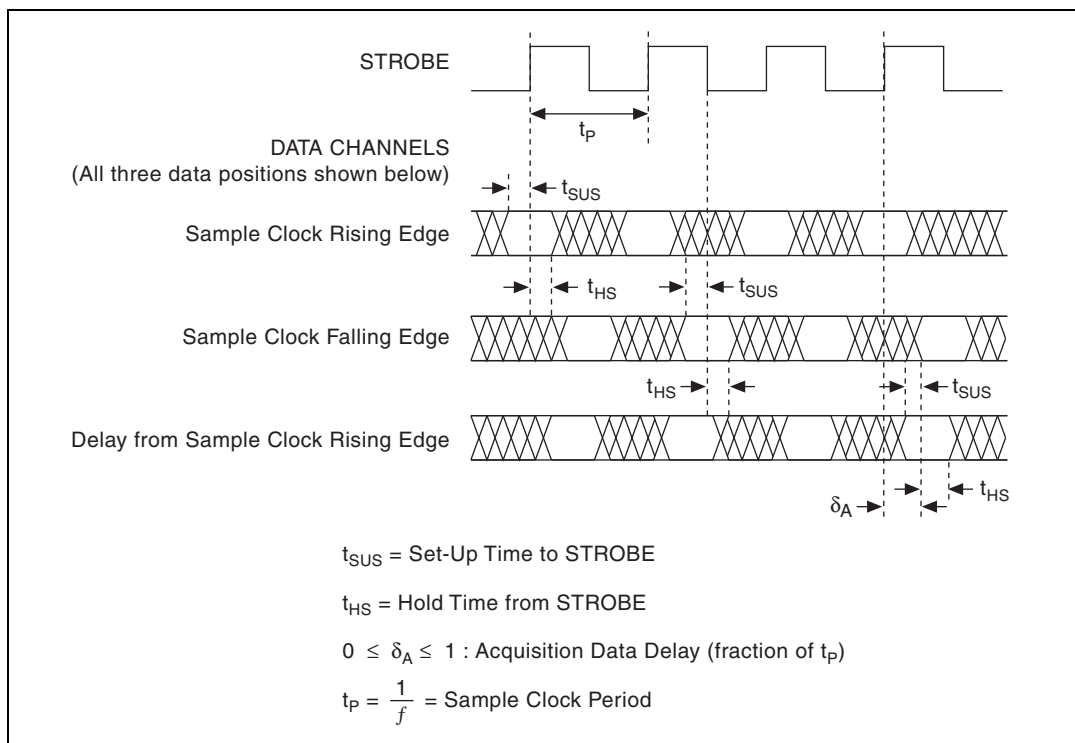


Figure 4. Acquisition Timing Diagram Using STROBE as the Sample Clock

CLK IN (SMB Jack Connector)

Specification	Value	Comments
Direction	Input into device	—
Destinations	1. Reference clock (for the phase lock loop (PLL)) 2. Sample clock	—
Input coupling	AC	—
Input protection	± 10 VDC	—
Input impedance	50 Ω (default) or 1 k Ω	Software-selectable
Minimum detectable pulse width	4 ns	Required at V_{rms} mean
Clock requirements	Clock must be continuous and free-running	—

Specification	Value				Comments
As Sample clock					
External Sample clock requirements	Square Waves				—
	Voltage range	0.65 V _{pp} to 5.0 V _{pp}			—
	Frequency range	NI 6551: 20 kHz to 50 MHz			—
		NI 6552: 20 kHz to 100 MHz			—
	Duty cycle range	$f < 50$ MHz: 25% to 75% $f \geq 50$ MHz: 40% to 60%			—
	Sine Waves				—
	Voltage range	0.65 V _{pp} to 5.0 V _{pp}	1.0 V _{pp} to 5.0 V _{pp}	2.0 V _{pp} to 5.0 V _{pp}	—
	Frequency range	NI 6551: 5.5 MHz to 50 MHz	NI 6551: 3.5 MHz to 50 MHz	NI 6551: 1.8 MHz to 50 MHz	—
		NI 6552: 5.5 MHz to 100 MHz	NI 6552: 3.5 MHz to 100 MHz	NI 6552: 1.8 MHz to 100 MHz	—
As Reference Clock					
Reference clock frequency range	10 MHz ± 50 ppm				—
Reference clock voltage range	0.65 V _{pp} to 5.0 V _{pp}				—
Reference clock duty cycle	25% to 75%				—

STROBE (DDC Connector)

Specification	Value		Comments
Direction	Input into device		—
Destinations	Sample clock (acquisition only)		—
STROBE frequency range	NI 6551: 48 Hz to 50 MHz NI 6552: 48 Hz to 100 MHz		—
STROBE duty cycle range	NI 6551: 25% to 75% NI 6552: $f \leq 50$ MHz: 25% to 75% $f > 50$ MHz: 40% to 60%		At the programmed thresholds
Minimum detectable pulse width	4 ns		Required at both acquisition voltage thresholds
Voltage thresholds	Refer to the <i>Acquisition Timing (Data, STROBE, and PFI <0..3> Channels)</i> specifications in the <i>Channel Specifications</i> section.		—
Clock requirements	Clock must be continuous and free-running.		—
Input impedance	Module Assemblies Labeled A and B	Module Assemblies Labeled C and Later	Software-selectable
	50 Ω or 10 k Ω (default)	50 Ω or 50 k Ω (default)	

PXI_STAR (PXI Backplane—PXI only)

Specification	Value	Comments
Direction	Input into device	—
Destinations	1. Sample clock 2. Start trigger 3. Reference trigger (acquisition sessions only) 4. Advance trigger (acquisition sessions only) 5. Pause trigger (generation sessions only) 6. Script trigger (generation sessions only)	—

Specification	Value	Comments
PXI_STAR frequency range	NI 6551: 48 Hz to 50 MHz NI 6552: 48 Hz to 100 MHz	—
Clock requirements	Clock must be continuous and free-running.	—

CLK OUT (SMB Jack Connector)

Specification	Value	Comments
Direction	Output from device	—
Sources	1. Sample clock (excluding STROBE) 2. Reference clock (PLL)	—
Output impedance	50 Ω nominal	—
As Sample Clock		
Electrical characteristics	Refer to the <i>Generation Channels (Data, DDC CLK OUT, and PFI <0..3>)</i> specifications in the <i>Channel Specifications</i> section.	—
As Reference Clock		
Maximum drive current	24 mA	—
Logic type	3.3 V CMOS	—

DDC CLK OUT (DDC Connector)

Specification	Value	Comments
Direction	Output from device	—
Sources	Sample clock	STROBE cannot be routed to DDC CLK OUT
Electrical characteristics	Refer to the <i>Generation Timing (Data, DDC CLK OUT, and PFI <0..3> Channels)</i> specifications in the <i>Channel Specifications</i> section.	—

Reference Clock (PLL)

Specification	Value	Comments
Reference clock sources	1. PXI_CLK10 (PXI backplane—PXI only) 2. RTSI 7 (RTSI bus—PCI only) 3. CLK IN (SMB jack connector) 4. None (On Board Clock not locked to a reference)	Provides the reference frequency for the PLL
Lock time	400 ms	Typical
Reference clock frequencies	10 MHz \pm 50 ppm	—
Reference clock duty cycle	25% to 75%	—
Reference clock destinations	CLK OUT (SMB jack connector)	—

Waveform Characteristics

Memory and Scripting

Specification	Value			Comments
Memory architecture	The NI 6551/6552 uses the Synchronization and Memory Core (SMC) technology in which waveforms and instructions share onboard memory. Parameters such as number of script instructions, maximum number of waveforms in memory, and number of samples (S) available for waveform storage are flexible and user-defined.			Refer to the <i>NI Digital Waveform Generator/ Analyzer Help</i> for more information.
Onboard memory size	1 Mbit/channel for generation sessions	8 Mbit/channel for generation sessions	64 Mbit/channel for generation sessions	Maximum limit for generation sessions assumes no scripting instructions.
	1 Mbit/channel for acquisition sessions	8 Mbit/channel for acquisition sessions	64 Mbit/channel for acquisition sessions	

Specification	Value		Comments
Generation modes	<p>Single-waveform mode: Generate a single waveform once, N times, or continuously.</p> <p>Scripted mode: Generate a simple or complex sequence of waveforms. Use scripts to describe the waveforms to be generated, the order in which the waveforms are generated, how many times the waveforms are generated, and how the device responds to Script triggers.</p>		—
Generation minimum waveform size	Configuration	Sample Rate	
		100 MHz (NI 6552 only)	50 MHz
	Finite waveform	2 S	2 S
	Continuous waveform	32 S	16 S
	Stepped triggered script	128 S	64 S
	Burst triggered script	512 S	256 S
Generation finite repeat count	1 to 16,777,216		—
Generation waveform quantum	Waveform size must be an integer multiple of 2 S.		Regardless of waveform size, NI-HSDIO allocates waveforms into block sizes of 32 S of physical memory.

Specification	Value	Comments
Acquisition minimum record size	1 S	—
Acquisition record quantum	1 record	—
Acquisition maximum number of records	2,147,483,647	—
Acquisition number of pre-Reference trigger samples	0 up to full record	—
Acquisition number of post-Reference trigger samples	0 up to full record	—

Triggers (Inputs to the NI 6551/6552)

Specification	Values			Comments
Trigger types	<ol style="list-style-type: none"> 1. Start trigger 2. Pause trigger 3. Script trigger (generation sessions only) 4. Reference trigger (acquisition sessions only) 5. Advance trigger (acquisition sessions only) 			—
Sources	<ol style="list-style-type: none"> 1. PFI 0 (SMB jack connector) 2. PFI <1..3> (DDC connector) 3. PXI_TRIG<0..7> (PXI backplane—PXI only)/RTSI <0..7> (RTSI bus—PCI only) 4. PXI_STAR (PXI backplane—PXI only) 5. Pattern match (acquisition sessions only) 6. Software (user function call) 7. Disabled (do not wait for a trigger) 			—
Trigger detection	<ol style="list-style-type: none"> 1. Start trigger (edge detection: rising or falling) 2. Pause trigger (level detection: high or low) 3. Script trigger <0..3> (edge detection: rising or falling; level detection: high or low) 4. Reference trigger (edge detection: rising or falling) 5. Advance trigger (edge detection: rising or falling) 			—
Minimum required trigger pulse width	Generation Triggers		Acquisition Triggers	—
	30 ns		Acquisition triggers must meet set-up and hold time requirements.	
Trigger rearm time	Start to Reference Trigger	Start to Advance Trigger	Reference to Reference Trigger	—
	57 S, typical; 64 S maximum	138 S, typical; 143 S, maximum	132 S, typical; 153 S, maximum	

Specification	Values		Comments
Destinations	1. PFI 0 (SMB jack connectors) 2. PFI <1..3> (DDC connector) 3. PXI_TRIG<0..7> (PXI backplane—PXI only)/ RTSI <0..7> (RTSI bus—PCI only)		Each trigger can be routed to any destination except the Pause trigger. The Pause trigger cannot be exported for acquisition sessions.
Delay from Pause trigger to Paused state	Generation Sessions	Acquisition Sessions	—
	32 Sample clock periods + 150 ns	Synchronous to the data	Use the Data Active event during generation to determine when the NI 6551/6552 enters the Pause state.
Delay from trigger to digital data output	32 Sample clock periods + 160 ns		—

Events (Output from the NI 6551/6552)

Specification	Value	Comments
Event type	<ol style="list-style-type: none"> 1. Marker <0..3> (generation sessions only) 2. Data Active event (generation sessions only) 3. Ready for Start event 4. Ready for Advance event (acquisition sessions only) 5. End of Record event (acquisition sessions only) 6. Sample Error event (hardware comparison sessions only) 7. Delayed Data Active event (hardware comparison sessions only) 	—
Destinations	<ol style="list-style-type: none"> 1. PFI 0 (SMB jack connectors) 2. PFI <1..3> (DDC connector) 3. PXI_TRIG<0..7> (PXI backplane—PXI only)/RTSI <0..7> (RTSI bus—PCI only) 	Each event, except the Data Active event, can be routed to any destination. The Data Active event can only be routed to PFI channels.
Marker time resolution (placement)	Markers must be placed at an integer multiple of 2 S	—

Calibration

Specification	Value	Comments
Interval for external calibration	2 years	—
Warm-up time	15 minutes	—
Onboard calibration voltage reference		
Temperature coefficient	± 5 ppm/ $^{\circ}\text{C}$	—
Long-term stability	90 ppm/ $\sqrt{\text{kHr}}$	Typical
On Board Clock characteristics (only valid when PLL reference source is set to None)		
Frequency accuracy	± 100 ppm	Typical
Temperature stability	± 30 ppm	Typical
Aging	± 5 ppm first year	Typical

Power

Specification	Value			Comments
	Typical	Maximum		
		PXI	PCI	
+3.3 VDC	2.0 A	2.0 A	2.0 A	—
+5 VDC	1.8 A	2.3 A	2.4 A	—
+12 VDC	0.3 A	0.5 A	0.5 A	—
−12 VDC	0.2 A	0.2 A	0.2 A	—
Total power	21.6 W	26.5 W	27.0 W	—

Software Specifications

Specification	Value	Comments
Driver software	NI-HSDIO driver software. NI-HSDIO allows you to configure, control, and calibrate the NI 6551/6552. NI-HSDIO provides application interfaces for many development environments. NI-HSDIO follows IVI API guidelines.	—
Application software	NI-HSDIO provides programming interfaces for the following application development environments (ADEs): <ul style="list-style-type: none"> National Instruments LabVIEW National Instruments LabWindows™/CVI™ Microsoft Visual C/C++ 	Refer to the <i>NI-HSDIO Instrument Driver Readme</i> for more information about supported ADE versions.
Test panel	National Instruments Measurement & Automation Explorer (MAX) provides test panels with basic acquisition and generation functionality for the NI 6551/6552. MAX is included on the NI-HSDIO driver DVD.	—

Environment








Note To ensure that the NI 6551/6552 cools effectively, follow the guidelines in the *Maintain Forced Air Cooling Note to Users* included with the device. The NI 6551/6552 is intended for indoor use only.

Specification	Value		Comments
Operating temperature	PXI	PCI	
	0 °C to +55 °C in all NI PXI chassis except the following: 0 °C to +45 °C when installed in an NI PXI-1000/B and NI PXI-101x chassis (Meets IEC-60068-2-1 and IEC-60068-2-2.)	0 °C to +45 °C	—
Storage temperature	–20 °C to 70 °C		—

Specification	Value	Comments
Operating relative humidity	10% to 90% relative humidity, noncondensing (Meets IEC-60068-2-56.)	—
Storage relative humidity	5% to 95% relative humidity, noncondensing (Meets IEC-60068-2-56.)	—
Operating shock	30 g, half-sine, 11 ms pulse (Meets IEC-60068-2-27. Test profile developed in accordance with MIL-PRF-28800F.)	PXI only
Storage shock	50 g, half-size, 11 ms pulse (Meets IEC-60068-2-27. Test profile developed in accordance with MIL-PRF-28800F.)	PXI only
Operating vibration	5 Hz to 500 Hz, 0.31 g _{rms} (Meets IEC-60068-2-64.)	PXI only
Storage vibration	5 Hz to 500 Hz, 2.46 g _{rms} (Meets 60068-2-64. Test profile exceeds requirements of MIL-PRF-28800F, Class B.)	PXI only
Altitude	0 m to 2,000 m above sea level (at 25 °C ambient temperature)	—
Pollution Degree	2	—

Safety, Electromagnetic Compatibility, and CE Compliance

Specification	Value	Comments
Safety	<p>The NI 6551/6552 meets the requirements of the following standards of safety for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IEC 61010-1, EN 61010-1 • UL 61010-1, CSA 61010-1 	For UL and other safety certifications, refer to the product label or visit ni.com/certification , search by model number or product line, and click the appropriate link in the <i>Certification</i> column.
Electromagnetic Compatibility	<p>The NI 6551/6552 meets the requirements of the following EMC standards for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 61326-1 (IEC 61326-1): Class A emissions, Basic immunity • EN 55011 (CISPR 11): Group 1, Class A emissions • AS/NZS CISPR 11: Group 1, Class A emissions • FCC 47 CFR Part 15B: Class A emissions • ICES-001: Class A emissions <p>For the standards applied to assess the EMC of this product, refer to the <i>Online Product Certification</i> section of this document.</p> <p>To meet EMC compliance the following cautions apply:</p> <div>  <p>Caution The SHC68-C68-D4 or SHC68-C68-D2 shielded cables must be used when operating the NI 6551/6552.</p> </div> <div>  <p>Caution EMI filler panels (NI P/N 778700-01) must be installed in all empty slots of the NI 6551/6552.</p> </div>	

CE Compliance	<p>This product meets the essential requirements of applicable European Directives, as amended for CE marking, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2006/95/EC; Low-Voltage Directive (safety) • 2004/108/EC; Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 	
Online Product Certification	<p>Refer to the product Declaration of Conformity (DoC) for additional regulatory compliance information. To obtain product certifications and the DoC for this product, visit ni.com/certification, search by model number or product line, and click the appropriate link in the <i>Certification</i> column.</p>	—
Environmental Management	<p>NI is committed to designing and manufacturing products in an environmentally responsible manner. NI recognizes that eliminating certain hazardous substances from our products is beneficial to the environment and to NI customers.</p> <p>For additional environmental information, refer to the <i>NI and the Environment</i> Web page at ni.com/environment. This page contains the environmental regulations and directives with which NI complies, as well as other environmental information not included in this document</p>	—
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)	<p>EU Customers: At the end of the product life cycle, all products <i>must</i> be sent to a WEEE recycling center. For more information about WEEE recycling centers, National Instruments WEEE initiatives and compliance with WEEE Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment, visit ni.com/environment/weee.</p>	
<div>  <p>中国客户 National Instruments 符合中国电子信息产品中限制使用某些有害物质指令 (RoHS)。关于 National Instruments 中国 RoHS 合规性信息，请登录 ni.com/environment/rohs_china。(For information about China RoHS compliance, go to ni.com/environment/rohs_china.)</p> </div> <h3>电子信息产品污染控制管理办法（中国 RoHS）</h3>		

Physical Specifications

Specification	Value		Comments
Dimensions	PXI	PCI	
	18.6 cm × 13.1 cm (7.32 in. × 5.16 in.) Single 3U CompactPCI slot; PXI compatible	12.6 cm × 35.5 cm (4.95 in. × 13.9 in.)	—
Weight	375 g (13.2 oz)		—
Front Panel Connectors			
Label	Function(s)	Connector Type	—
CLK IN	External Sample clock, external PLL reference input	SMB jack connector	—
PFI 0	Events, triggers	SMB jack connector	—
CLK OUT	Exported Sample clock, exported Reference clock	SMB jack connector	—
DIGITAL DATA & CONTROL	Digital data channels, exported Sample clock, STROBE, events, triggers	68-pin VHDCI connector	—

CVI, LabVIEW, National Instruments, NI, ni.com, the National Instruments corporate logo, and the Eagle logo are trademarks of National Instruments Corporation. Refer to the *Trademark Information* at ni.com/trademarks for other National Instruments trademarks. The mark LabWindows is used under a license from Microsoft Corporation. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Other product and company names mentioned herein are trademarks or trade names of their respective companies. For patents covering National Instruments products/technology, refer to the appropriate location: **Help»Patents** in your software, the `patents.txt` file on your media, or the *National Instruments Patent Notice* at ni.com/patents.

NI PXI/PCI-6551/6552 仕様

50/100 MHz デジタル波形発生器 / アナライザ

このドキュメントには、NI PXI/PCI-6551 (NI 6551) および NI PXI/PCI-6552 (NI 6552) の仕様が記載されています。

「標準」値は、室温で動作する平均単位です。仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。最新の NI 6551/6552 の仕様については、ni.com/manuals をご覧ください。

NI 6551/6552 信号の機能的な説明が記載されている『NI デジタル波形発生器 / アナライザスタートアップガイド』を含む、NI 6551/6552 のドキュメントは、**スタート→プログラム→National Instruments→NI-HSDIO→ドキュメント**から参照できます。



熱面

NI 6551/6552 を長時間使用している場合、安全取り扱い温度を超え、火傷をする可能性があります。シャーシから取り外す前に、十分に冷却してください。



メモ

すべての値は、1 メートルケーブル (SHC68-C68-D4 を推奨) を使用して取得されたものです。指定より長いケーブルを使用した場合、性能仕様は保証されません。

目次

チャンネル仕様.....	3
生成チャンネル（データ、DDC CLK OUT、および PFI <0..3>）.....	4
集録チャンネル（データ、STROBE、および PFI <0..3>）.....	5
ハードウェア比較.....	6
タイミング仕様.....	6
サンプルクロック.....	6
生成タイミング（データ、DDC CLK OUT、 および PFI <0..3> チャンネル）.....	7
集録タイミング（データ、STROBE、 および PFI <0..3> チャンネル）.....	10
CLK IN（SMB ジャックコネクタ）.....	13
STROBE（DDC コネクタ）.....	15
PXI_STAR（PXI バックプレーン—PXI のみ）.....	15
CLK OUT（SMB ジャックコネクタ）.....	16
DDC CLK OUT（DDC コネクタ）.....	16
基準クロック（PLL）.....	17
波形特性.....	17
メモリおよびスクリプト.....	17
トリガ（NI 6551/6552 への入力）.....	19
イベント（NI 6551/6552 から出力）.....	20
キャリブレーション.....	21
電源.....	21
ソフトウェア仕様.....	22
環境.....	22
安全性、電磁両立性、CE 準拠.....	24
物理特性.....	26

チャンネル仕様

仕様	値	コメント
データ チャンネル数	20	—
データチャンネルの 入出力方向制御	各チャンネル、各サイクル、双方向	—
PFI（プログラム 可能関数インタフェース） チャンネル数	4	詳細については、 「 波形特性 」セクションを参照。
PFI チャンネル の入出力方向 制御	各チャンネルごと	—
クロック端子 数	3 入力、 2 出力	詳細については、 「 タイミング仕様 」セクションを参照。

生成チャンネル（データ、DDC CLK OUT、および PFI <0..3>）

仕様	値		コメント
生成電圧レンジ	-2.0 ~ 5.5 V		1 MΩ 負荷
生成信号タイプ	シングルエンド		—
プログラムで設定可能な電圧レベルの数	1 電圧 LOW レベル 1 電圧 HIGH レベル メモ ：生成チャンネルおよび集録チャンネルにはそれぞれ 1 つの低電圧および高電圧レベルのみ設定可能ですが、生成チャンネルと集録チャンネルは異なる電圧レベルを設定することができます。チャンネルを高インピーダンス（トライステート）に設定することができます。		すべてのデータで CLK OUT（サンプルクロックのみ）、および PFI チャンネル
生成電圧レンジ制限	-0.5 ~ 5.5 V（最大 50 MHz クロックレート） -2.0 ~ 3.7 V（最大 50 MHz クロックレート） -0.5 ~ 3.7 V（50 MHz ~ 100 MHz クロックレート、NI 6552 のみ）		1 MΩ 負荷
生成電圧振幅	400 mV ~ 6 V（最大 50 MHz クロックレート） 400 mV ~ 4.2 V（50 MHz ~ 100 MHz クロックレート、NI 6552 のみ）		1 MΩ 負荷
生成電圧レベル分解能	10 mV		1 MΩ 負荷
DC 生成電圧レベル精度	±20 mV		1 MΩ 負荷、システムクロストークは除く
出力インピーダンス	50 Ω（公称）		25 °C 時
出力インピーダンス温度係数	0.2 Ω/ °C		標準
最大 DC 出力電流強度	±50 mA（チャンネルあたり）、 最大 ±600 mA（すべてのデータ、クロック、および PFI チャンネル）		—
データチャンネル駆動有効 / 無効制御	各チャンネル / サイクル		—
チャンネル電源投入時の状態	モジュールアセンブリ (A および B のラベル)	モジュールアセンブリ (C 以降のラベル)	—
	ドライバ無効、10 kΩ 入力インピーダンス	ドライバ無効、50 kΩ 入力インピーダンス	
出力保護	デバイスは、生成電圧レンジ内の電圧であれば短絡に対して無限に耐えることができます。		—

集録チャンネル（データ、STROBE、および PFI <0..3>）

仕様	値		コメント
チャンネルあたりの電圧比較器数	2		—
集録電圧レンジ	-2.0 ~ 5.5 V		—
プログラム可能な集録しきい値数	1 電圧 LOW しきい値 1 電圧 HIGH しきい値 メモ ：生成チャンネルおよび集録チャンネルにはそれぞれ 1 つの低電圧および高電圧レベルのみ設定可能ですが、生成チャンネルと集録チャンネルには異なる電圧レベルを設定することができます。チャンネルを高インピーダンス（トリステート）に設定することができます。		すべてのデータ、STROBE、および PFI チャンネル
検知可能な最小電圧振幅	50 mV		10 k Ω 入力インピーダンス、50% デューティサイクル入力信号で測定
集録電圧しきい値分解能	10 mV		10 k Ω 入力インピーダンス
DC 集録電圧しきい値確度	± 30 mV		10 k Ω 入力インピーダンス、システムクロストークは除く
入力インピーダンス	モジュールアセンブリ (A および B のラベル)	モジュールアセンブリ (C 以降のラベル)	電源投入時および有効な電圧レンジ内であればチャンネルごとにソフトウェアで選択可能。
	50 Ω 公称または 10 k Ω （デフォルト）	50 Ω 公称または 50 k Ω （デフォルト）	
入力保護	-2.3 ~ 6.8 V		設計のダイオードクランプは、この範囲外で追加保護を提供できる場合がある。

ハードウェア比較

仕様	値	コメント
エラー FIFO 深度	4,094	エラーデータのフェッチについては、『NI デジタル波形発生器 / アナライザヘルプ』を参照。
繰り返しエラー数	255	—
速度（最大）	NI 6551: 50 MHz NI 6552: 100 MHz	—

タイミング仕様

サンプルクロック

仕様	値	コメント
サンプルクロックソース	1. オンボードクロック（内部電圧制御水晶発振器（VCXO）ディバイダ付） 2. CLK IN（SMB ジャックコネクタ） 3. PXI_STAR（PXI バックプレーン—PXI のみ） 4. STROBE（DDC コネクタ、集録のみ）	—
オンボードクロック周波数範囲	NI 6551: 48 Hz ～ 50 MHz、200 MHz/ N に構成可能 ($4 \leq N \leq 4,194,304$) NI 6552: 48 Hz ～ 100 MHz、200 MHz/ N に構成可能 ($2 \leq N \leq 4,194,304$)	—
CLK IN 周波数レンジ	NI 6551: 20 kHz ～ 50 MHz NI 6552: 20 kHz ～ 100 MHz	波形タイプによる制限については、「 CLK IN (SMB ジャックコネクタ) 」セクションを参照。
PXI_STAR 周波数レンジ (PXI のみ)	NI 6551: 48 Hz ～ 50 MHz NI 6552: 48 Hz ～ 100 MHz	「 PXI_STAR (PXI バックプレーン—PXI のみ) 」セクションを参照。

仕様	値		コメント
STROBE 周波数範囲	NI 6551: 48 Hz ~ 50 MHz NI 6552: 48 Hz ~ 100 MHz		「STROBE (DDC コネクタ)」セク ションを参照。
サンプルク ロック相対 遅延の調整	0.0 ~ 1.0 サンプルクロック周期		遅延または位相 調整をオンボー ドクロックに適 用して複数のデ バイスを合わせ ることが可能。
サンプルク ロック相対遅 延の調整分解 能	10 ps		
エクスポート したサンプル クロックの出 力先	1. DDC CLK OUT (DDC コネクタ) 2. CLK OUT (SMB ジャックコネクタ)		STROBE 以外の ソースのあるサ ンプルクロック がエクスポート される。
エクスポート したサンプ ルクロックの遅 延範囲 (δ_C)	0.0 ~ 1.0 サンプルクロック周期		クロック周波数 が 25 MHz 以上 の場合
エクスポート したサンプ ルクロックの遅 延分解能 (δ_C)	サンプルクロック周期の 1/256		クロック周波数 が 25 MHz 以上 の場合
エクスポート したサンプ ルクロックジッ タ	周期ジッタ	サイクル間ジッタ	標準、オンボー ドクロックを使用
	20 ps _{rms}	35 ps _{rms}	

生成タイミング (データ、DDC CLK OUT、および PFI <0..3> チャンネル)

仕様	値		コメント
データチャンネル間スキュー	標準	最大	すべてのチャンネルでの値
	±300 ps	±900 ps	
最大データチャンネルトグルレート	NI 6551: 25 MHz NI 6552: 50 MHz		—
データ形式	非ゼロ復帰 (NRZ)		—

仕様	値	コメント
データ位置モード	サンプルクロック立ち上がりエッジ、サンプルクロック立ち下りエッジ、またはサンプルクロック立ち上がりエッジの遅延	各チャンネルごと
生成データ遅延範囲 (δ_G)	0.0 ～ 1.0 サンプルクロック周期	クロック周波数が 25 MHz 以上の場合
生成データ遅延分解能 (δ_G)	サンプルクロック周期の 1/256	クロック周波数が 25 MHz 以上の場合

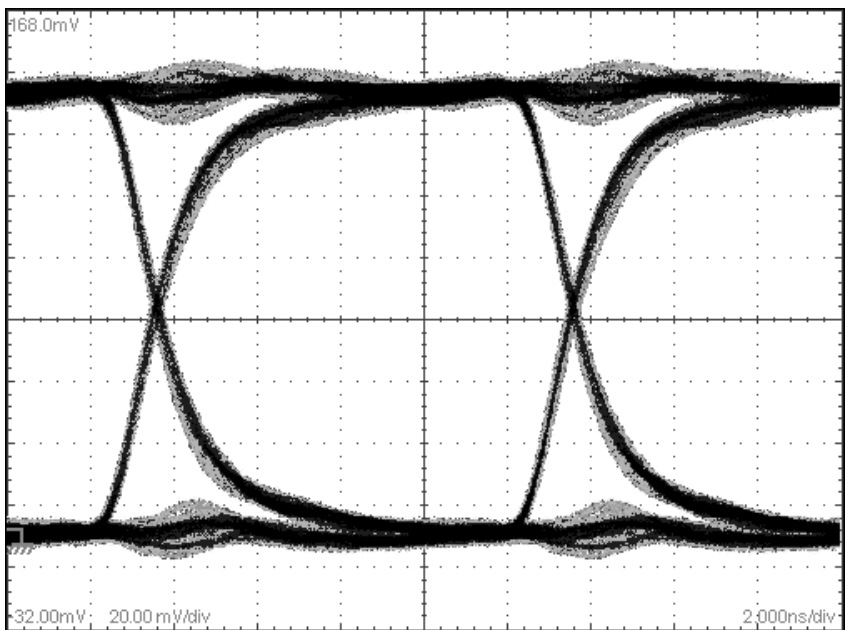
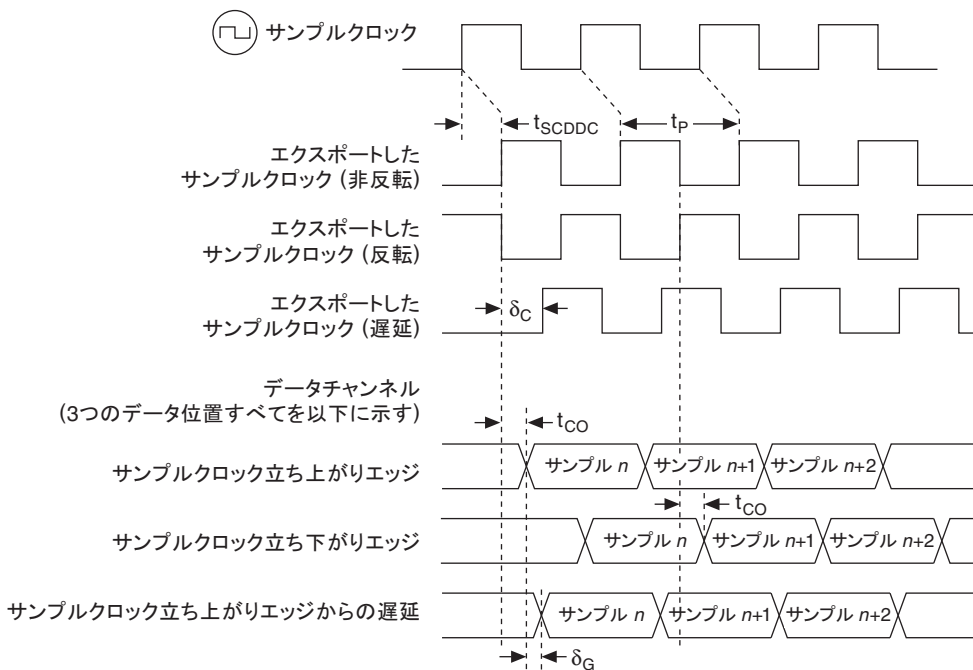


図 1 アイダイアグラム¹

¹ このアイダイアグラムは、50 Ω の終端へ出力する DIO 0 (100 MHz クロックレート) を 3.3 V 時にキャプチャしたもの。
(室温時)

仕様	値		コメント
立ち上がり時間 (0 ~ 3.3 V 振幅)	50 Ω 負荷	1 M Ω 負荷	20 ~ 80% (標準)
	2.25 ns	2.75 ns (475 pF テストシステムキャパシタンスの場合)	
立ち下がり時間 (0 ~ 3.3 V 振幅)	2.25 ns	2.75 ns (475 pF テストシステムキャパシタンスの場合)	20 ~ 80% (標準)
エクスポートしたサンプルクロックオフセット (t_{CO})	0 ns または 2.5 ns (デフォルト)		ソフトウェアで選択可能
サンプルクロック (内部) から DDC コネクタまでの時間遅延 (t_{SCDDC})	32.5 ns		標準



t_{SCDDC} : 内部サンプルクロックからDDCコネクタのエクスポートしたサンプルクロックまでの遅延

$0 \leq \delta_C \leq 1$: エクスポートしたサンプルクロック遅延 (t_p の割合)

$0 \leq \delta_G \leq 1$: 生成データ遅延 (t_p の割合)

$t_p = \frac{1}{f}$ = サンプルクロック周期

t_{CO} = エクスポートしたサンプルクロックオフセット: 0または2.5 ns、ソフトウェアで選択可能

図2 生成タイミング図

集録タイミング (データ、STROBE、および PFI <0..3> チャンネル)

仕様	値		コメント
データチャンネル間スキュー	標準	最大	すべてのチャンネルでの値
	±400 ps	±900 ps	
検出可能な最小パルス幅	4 ns		両方の集録電圧しきい値が必要

仕様	値	コメント
STROBE までのセットアップ時間 (t_{SUS})	2.3 ns	最大。最大データチャンネル間スキューを含む
STROBE までのホールド時間 (t_{HS})	1.9 ns	最大。最大データチャンネル間スキューを含む
DDC コネクタデータから内部サンプルクロックまでの時間遅延 (t_{DDCSC})	27.5 ns	標準
サンプルクロックロックまでのセットアップ時間 (t_{SUSC})	0.4 ns	データチャンネル間スキュー、 t_{DDCSC} 、または t_{SCDDC} は含まれません。
サンプルクロックロックまでのホールド時間 (t_{HSC})	0 ns	データチャンネル間スキュー、 t_{DDCSC} 、または t_{SCDDC} は含まれません。
データ位置モード	サンプルクロック立ち上がりエッジ、サンプルクロック立ち下りエッジ、またはサンプルクロック立ち上がりエッジの遅延	各チャンネルごと
集録データ遅延範囲 (δ_A)	0.0 ~ 1.0 サンプルクロック周期	クロック周波数が 25 MHz 以上の場合
集録データ遅延分解能 (δ_A)	サンプルクロック周期の 1/256	クロック周波数が 25 MHz 以上の場合

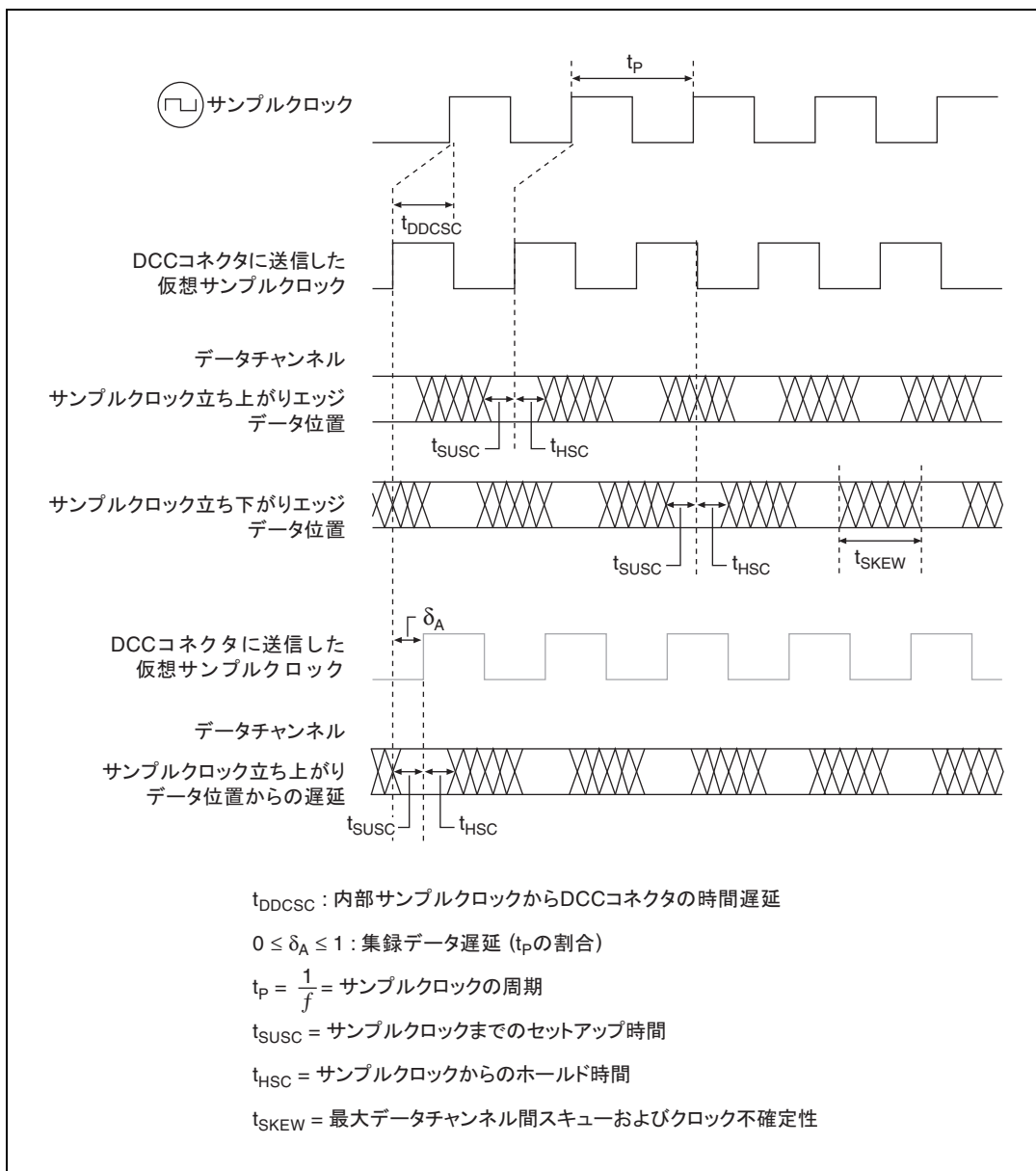


図3 集録タイミング図



メモ

提供されるセットアップおよびホールド時間には最大チャンネル間スキューおよびジッタを含みます。

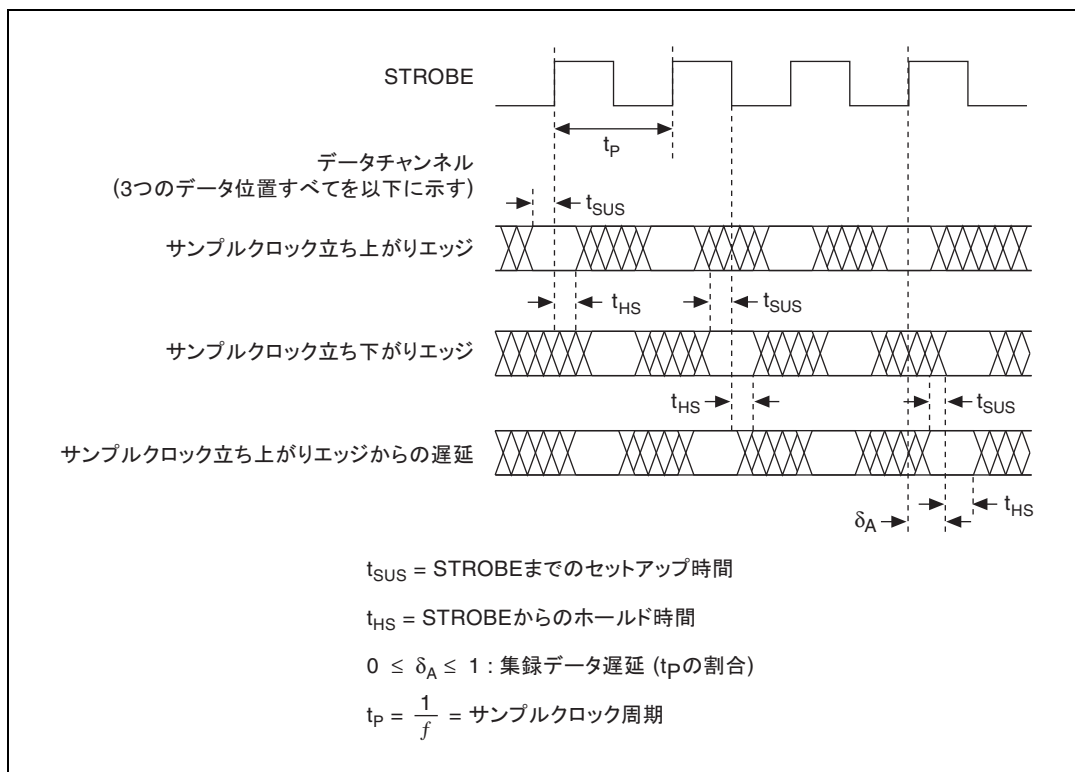


図 4 STROBE をサンプルクロックとして使用する集録タイミング図

CLK IN (SMB ジャックコネクタ)

仕様	値	コメント
方向	デバイスへの入力	—
出力先	1. 基準クロック (PLL: 位相ロックループ) 2. サンプルクロック	—
入力カプリング	AC	—
入力保護	± 10 VDC	—
入力インピーダンス	50 Ω (デフォルト) または 1 k Ω	ソフトウェアで選択可能
検出可能な最小パルス幅	4 ns	V_{rms} 平均値で必要
クロック要件	クロックは連続および自由実行であること	—

仕様	値				コメント
サンプルクロックの場合					
外部サンプルクロックの要件	方形波				—
	電圧レンジ	0.65 V _{pp} ~ 5.0 V _{pp}			—
	周波数範囲	NI 6551: 20 kHz ~ 50 MHz			—
		NI 6552: 20 kHz ~ 100 MHz			—
	デューティーサイクルレンジ	f < 50 MHz: 25 ~ 75% f ≥ 50 MHz: 40 ~ 60%			—
	正弦波				—
	電圧レンジ	0.65 V _{pp} ~ 5.0 V _{pp}	1.0 V _{pp} ~ 5.0 V _{pp}	2.0 V _{pp} ~ 5.0 V _{pp}	—
	周波数範囲	NI 6551: 5.5 MHz ~ 50 MHz	NI 6551: 3.5 MHz ~ 50 MHz	NI 6551: 1.8 MHz ~ 50 MHz	—
		NI 6552: 5.5 MHz ~ 100 MHz	NI 6552: 3.5 MHz ~ 100 MHz	NI 6552: 1.8 MHz ~ 100 MHz	—
基準クロックの場合					
基準クロックの周波数範囲	10 MHz ± 50 ppm				—
基準クロックの電圧レンジ	0.65 V _{pp} ~ 5.0 V _{pp}				—
基準クロックのデューティーサイクル	25 ~ 75%				—

STROBE (DDC コネクタ)

仕様	値		コメント
方向	デバイスへの入力		—
出力先	サンプルクロック (集録のみ)		—
STROBE 周波数範囲	NI 6551: 48 Hz ~ 50 MHz NI 6552: 48 Hz ~ 100 MHz		—
STROBE デューティ サイクルレン ジ	NI 6551: 25 ~ 75% NI 6552: $f \leq 50$ MHz: 25 ~ 75% $f > 50$ MHz: 40 ~ 60%		プログラムし きい値の場合
検出可能な最 小パルス幅	4 ns		両方の集録電 圧しきい値で 必要
電圧しきい値	「チャンネル仕様」セクションの「集録タイミング (データ、STROBE、および PFI <0..3> チャンネル)」仕様を参照してください。		—
クロック要件	クロックは連続および自走であること。		—
入力インピー ダンス	モジュールアセンブリ (A および B のラベル)	モジュールアセンブリ (C 以降のラベル)	ソフトウェア で選択可能
	50 Ω または 10 k Ω (デフォルト)	50 Ω または 50 k Ω (デフォルト)	

PXI_STAR (PXI バックプレーン—PXI のみ)

仕様	値	コメント
方向	デバイスへの入力	—
出力先	1. サンプルクロック 2. 開始トリガ 3. 基準トリガ (集録セッションのみ) 4. アドバンストリガ (集録セッションのみ) 5. 一時停止トリガ (生成セッションのみ) 6. スクリプトトリガ (生成セッションのみ)	—
PXI_STAR 周波数範囲	NI 6551: 48 Hz ~ 50 MHz NI 6552: 48 Hz ~ 100 MHz	—
クロック要件	クロックは連続および自走であること。	—

CLK OUT (SMB ジャックコネクタ)

仕様	値	コメント
方向	デバイスから出力	—
ソース	1. サンプルクロック (STROBE を除く) 2. 基準クロック (PLL)	—
出力インピーダンス	50 Ω (公称)	—
サンプルクロックの場合		
電気特性	「チャンネル仕様」セクションの「生成チャンネル (データ、DDC CLK OUT、および PFI <0..3>)」仕様を参照してください。	—
基準クロックの場合		
最大駆動電流	24 mA	—
論理タイプ	3.3 V CMOS	—

DDC CLK OUT (DDC コネクタ)

仕様	値	コメント
方向	デバイスから出力	—
ソース	サンプルクロック	STROBE は DDC CLK OUT に経路設定不可
電気特性	「チャンネル仕様」セクションの「生成タイミング (データ、DDC CLK OUT、および PFI <0..3> チャンネル)」仕様を参照してください。	—

基準クロック（PLL）

仕様	値	コメント
基準クロックソース	1. PXI_CLK10（PXI バックプレーン —PXI のみ） 2. RTSI 7（RTSI バス —PCI のみ） 3. CLK IN（SMB ジャックコネクタ） 4. なし（基準にロックされていないオンボードクロック）	PLL の基準周波数を提供
ロック時間	400 ms	標準
基準クロック周波数	10 MHz \pm 50 ppm	—
基準クロックのデューティーサイクル	25 ~ 75%	—
基準クロック周波数の出力先	CLK OUT（SMB ジャックコネクタ）	—

波形特性

メモリおよびスクリプト

仕様	値			コメント
メモリアーキテクチャ	NI 6551/6552 は、波形と命令がオンボードメモリを共有する SMC（Synchronization and Memory Core）テクノロジーを使用しています。スクリプト命令数、メモリ内の最大波形数、および波形ストレージで利用できるサンプル数などのパラメータは、柔軟性がありユーザ定義可能。			詳細については、『NI デジタル波形発生器 / アナライザヘルプ』を参照。
オンボードメモリサイズ	1 M ビット / チャンネル (生成セッション) 1 M ビット / チャンネル (集録セッション)	8 M ビット / チャンネル (生成セッション) 8 M ビット / チャンネル (集録セッション)	64 M ビット / チャンネル (生成セッション) 64 M ビット / チャンネル (集録セッション)	生成セッションの最大制限は、スクリプトの命令がないことが前提。
生成モード	単一波形モード ：単一の波形を一回、 N 回、または連続して生成します。 スクリプトモード ：シンプルまたは複雑な波形のシーケンスを生成します。スクリプトを使用して、生成する波形、波形が生成される順序、生成する波形数、およびスクリプトトリガにデバイスがどのように反応するかを示します。			—

仕様	値			コメント
生成最小波形 サイズ	構成	サンプルレート		サンプルレート に依存。サンプル レートを上げる と最小波形サイ ズの要件が増加。 これらの構成の 詳細については、 『NI デジタル波形 発生器 / アナライ ザヘルプ』の 「一般的なスクリ プトの使用」を 参照。
		100 MHz (NI 6552 のみ)	50 MHz	
	有限波形	2 S	2 S	
	連続波形	32 S	16 S	
	ステップトリガス クリプト	128 S	64 S	
	バーストリガス クリプト	512 S	256 S	
有限生成繰り 返し回数	1 ~ 16,777,216			—
生成波形量	波形サイズは、2 S の整数倍である必要あり。			波形サイズに関 係なく、 NI-HSDIO は波形 を物理メモリの 32 S ブロックサ イズに割り当て ます。
集録最小レ コードサイズ	1 S			—
集録レコード 量	1 レコード			—
最大集録レ コード数	2,147,483,647			—
基準前のトリ ガサンプル集 録数	0 ~ 最大レコード			—
基準後のトリ ガサンプル集 録数	0 ~ 最大レコード			—

トリガ (NI 6551/6552 への入力)

仕様	値			コメント
トリガタイプ	1. 開始トリガ 2. 一時停止トリガ 3. スクリプトトリガ (生成セッションのみ) 4. 基準トリガ (集録セッションのみ) 5. アドバンストリガ (集録セッションのみ)			—
ソース	1. PFI 0 (SMB ジャックコネクタ) 2. PFI <1..3> (DDC コネクタ) 3. PXI_TRIG<0..7> (PXI バックプレーン —PXI のみ) RTSI<0..7> (RTSI バス —PCI のみ) 4. PXI_STAR (PXI バックプレーン —PXI のみ) 5. パターンマッチ (集録セッションのみ) 6. ソフトウェア (ユーザによる関数呼び出し) 7. 無効 (トリガ待機なし)			—
トリガ検出	1. 開始トリガ (エッジ検出: 立ち上がりまたは立ち下がり) 2. 一時停止トリガ (レベル検出: HIGH もしくは LOW) 3. スクリプトトリガ <0..3> (エッジ検出: 立ち上がりまたは立ち下がり、レベル検出: HIGH もしくは LOW) 4. 基準トリガ (エッジ検出: 立ち上がりまたは立ち下がり) 5. アドバンストリガ (エッジ検出: 立ち上がりまたは立ち下がり)			—
必要最小トリガパルス幅	生成トリガ		集録トリガ	—
	30 ns		集録トリガは、セットアップおよびホールド時間の要件を満たす必要があります。	
トリガリアーム時間	開始～基準トリガ	開始～アドバンストリガ	基準～基準トリガ	—
	57 S (標準)、 64 S (最大)	138 S (標準)、 143 S (最大)	132 S (標準)、 153 S (最大)	
出力先	1. PFI 0 (SMB ジャックコネクタ) 2. PFI <1..3> (DDC コネクタ) 3. PXI_TRIG<0..7> (PXI バックプレーン —PXI のみ) RTSI <0..7> (RTSI バス —PCI のみ)			各トリガは、一時停止トリガ以外すべての出力先にルーティング可能。一時停止トリガは集録セッションにエクスポート不可。

仕様	値		コメント
一時停止トリガから一時停止状態までの遅延	生成セッション	集録セッション	—
	32 サンプルクロック周期 + 150 ns	データに同期	生成中にデータアクティブイベントを使用して、NI 6551/6552 が一時停止状態に入るタイミングを決定。
トリガからデジタルデータ出力までの遅延	32 サンプルクロック周期 + 160 ns		—

イベント (NI 6551/6552 から出力)

仕様	値	コメント
イベントタイプ	<ol style="list-style-type: none"> 1. マーカ <0..3> (生成セッションのみ) 2. データアクティブイベント (生成セッションのみ) 3. 開始準備完了イベント 4. アドバンス準備完了イベント (集録セッションのみ) 5. レコード完了イベント (集録セッションのみ) 6. サンプルエラーイベント (ハードウェア比較セッションのみ) 7. 遅延が追加されたデータアクティブイベント (ハードウェア比較セッションのみ) 	—
出力先	<ol style="list-style-type: none"> 1. PFI 0 (SMB ジャックコネクタ) 2. PFI <1..3> (DDC コネクタ) 3. PXI_TRIG<0..7> (PXI バックプレーン —PXI のみ) RTSI <0..7> (RTSI バス —PCI のみ) 	各イベントは、データアクティブイベント以外すべての出力先にルーティング可能。データアクティブイベントは、PFI チャンネルのみにルーティング可能。
マーカ時間分解能 (配置)	マーカは、2 S の整数倍で配置される必要があります。	—

キャリブレーション

仕様	値	コメント
外部キャリブレーション間隔	2 年間	—
ウォームアップ時間	15 分	—
オンボードキャリブレーション電圧基準		
温度係数	±5 ppm/ °C	—
長時間安定性	90 ppm/ $\sqrt{\text{kHr}}$	標準
オンボードクロック特性 (PLL 基準ソースがなしに設定されている場合のみに有効)		
周波数確度	±100 ppm	標準
温度安定性	±30 ppm	標準
経時特性	±5 ppm (1 年目)	標準

電源

仕様	値			コメント
	標準	最大		
		PXI	PCI	
+3.3 VDC	2.0 A	2.0 A	2.0 A	—
+5 VDC	1.8 A	2.3 A	2.4 A	—
+12 VDC	0.3 A	0.5 A	0.5 A	—
−12 VDC	0.2 A	0.2 A	0.2 A	—
合計電力	21.6 W	26.5 W	27.0 W	—

ソフトウェア仕様

仕様	値	コメント
ドライバソフトウェア	NI-HSDIO ドライバソフトウェア。NI-HSDIO は、NI 6551/6552 の構成、制御、キャリブレーションを可能にし、さまざまな開発環境のアプリケーションインタフェースを提供します。NI-HSDIO は、IVI API ガイドラインに準拠しています。	—
アプリケーションソフトウェア	NI-HSDIO は、以下のアプリケーション開発環境（ADE）でのプログラミングインタフェースを提供します。 <ul style="list-style-type: none"> National Instruments LabVIEW National Instruments LabWindows™/CVI™ Microsoft Visual C/C++ 	サポートされている各 ADE のバージョンについては、『NI-HSDIO 計測器ドライバ Readme』を参照。
テストパネル	NI Measurement & Automation Explorer (MAX) も NI 6551/6552 対応の集録および生成の基本機能を搭載したテストパネルを提供しています。MAX は NI-HSDIO 計測器ドライバ DVD に含まれています。	—

環境






メモ



NI 6551/6552 の効率的な冷却方法については、デバイスに含まれている『強制空冷の維持について』のガイドラインに従ってください。NI 6551/6552 は、室内での使用を意図して設計されています。

仕様	値		コメント
動作温度	PXI	PCI	
	0 ～ + 55 °C（以下を除くすべての NI PXI シャーシ） 0 ～ +45 °C（NI PXI-1000/B および NI PXI-101x シャーシ（IEC-60068-2-1 および IEC-60068-2-2 に準拠）に取り付けられた場合）	0 ～ +45 °C	—
保管温度	-20 ～ 70 °C		—
動作時の相対湿度	10 ～ 90%（相対湿度）、結露なきこと（IEC-60068-2-56 に準拠）		—
保管時の相対湿度	相対湿度 5 ～ 95 %、結露なきこと（IEC-60068-2-56 に準拠）		—

仕様	値	コメント
動作衝撃	30 g（半正弦波）、11 ms パルス（IEC-60068-2-27 に準拠、MIL-PRF-28800F に準拠してテストプロファイルを確立）	PXI のみ
保管時衝撃	50 g（半正弦波）、11 ms パルス（IEC-60068-2-27 に準拠、MIL-PRF-28800F に準拠してテストプロファイルを確立）	PXI のみ
動作振動	5 ～ 500 Hz、0.31 g _{rms} （IEC-60068-2-64 に準拠）	PXI のみ
保管時振動	5 Hz ～ 500 Hz、2.46 g _{rms} （IEC-60068-2-64 に準拠、テストプロファイルは MIL-PRF-28800F、Class B の要件以上）	PXI のみ
高度	海拔 0 ～ 2,000 m（周囲温度 25 °C 時）	—
汚染度	2	—

安全性、電磁両立性、CE 準拠

仕様	値	コメント
安全性	<p>NI 6551/6552 は、計測、制御、実験に使用される電気装置に関する以下の規格および安全性の要件を満たします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • IEC 61010-1、EN 61010-1 • UL 61010-1、CSA 61010-1 	<p>UL および準拠する安全規格については、ni.com/certification (英語) にアクセスして型番または製品ラインで検索し、保証の欄の該当するリンクをクリックしてください。</p>
電磁両立性	<p>NI 6551/6552 は、計測、制御、実験に使用される電気装置に関する以下の規格および EMC 規格を満たします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 61326-1 (IEC 61326-1): Class A エミッション、基本イミュニティ • EN 55011 (CISPR 11): Group 1、Class A エミッション • AS/NZS CISPR 11: Group 1、Class A エミッション • FCC 47 CFR Part 15B: Class A エミッション • ICES-001: Class A エミッション <p>製品の EMC 決定に適用する基準については、以下の「オンライン製品認証」セクションを参照してください。</p> <p>EMC に適合させるには、次の注意事項を適用してください。</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="margin-right: 10px; text-align: center;">  </div> <div> <p>注意 NI 6551/6552 を使用する際は、必ず SHC68-C68-D4 もしくは SHC68-C68-D2 シールドケーブルを使用してください。</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="margin-right: 10px; text-align: center;">  </div> <div> <p>注意 EMI フィラーパネル (NI P/N 778700-01) を NI 6551/6552 のすべての空きスロットに取り付けてください。</p> </div> </div>	
CE 準拠	<p>この製品は、以下のように、CE マーク改正に基づいて、該当する EC 理事会指令による基本的要件に適合しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2006/95/EC、低電圧指令 (安全性) • 2004/108/EC、電磁両立性指令 (EMC) 	

オンライン製品 認証	その他の適合規格については、適合宣言（DoC）をご覧ください。この製品の製品認証および適合宣言を入手するには、 ni.com/certification にアクセスして型番または製品ラインで検索し、保証の欄の該当するリンクをクリックしてください。	—
環境管理	ナショナルインスツルメンツは、環境に優しい製品の設計および製造に努めています。NI は、製品から特定の有害物質を除外することが、環境および NI のお客様にとって有益であると考えています。 環境の詳細な情報については、 ni.com/environment （英語）の「NI and the Environment」を参照してください。このページには、ナショナルインスツルメンツが準拠する環境規制および指令、およびこのドキュメントに含まれていないその他の環境に関する情報が記載されています。	—
廃電気電子機器 (WEEE)	欧州のお客様へ： 寿命末期を過ぎた製品は、すべて WEEE リサイクルセンターへ送る必要があります。WEEE リサイクルセンター、ナショナルインスツルメンツの WEEE への取り組み、および廃電気電子機器に関する WEEE 指令 2002/96/EC との準拠については、 ni.com/environment/weee （英語）を参照してください。	
<p style="text-align: center;">电子信息产品污染控制管理办法（中国 RoHS）</p> <p> 中国客户 National Instruments 符合中国电子信息产品中限制使用某些有害物质指令 (RoHS)。关于 National Instruments 中国 RoHS 合规性信息，请登录 ni.com/environment/rohs_china。(For information about China RoHS compliance, go to ni.com/environment/rohs_china.)</p>		

物理特性

仕様	値		コメント
外形寸法	PXI	PCI	
	18.6 × 13.1 cm (7.32 × 5.16 in.)、 3U 型 CompactPCI スロット、PXI 対応	12.6 × 35.5 cm (4.95 × 13.9 in.)	—
重量	375 g (13.2 oz)		—
フロントパネルコネクタ			
ラベル	機能	コネクタタイプ	—
CLK IN	外部サンプルクロック、外部 PLL 基準入力	SMB ジャックコネクタ	—
PFI 0	イベント、トリガ	SMB ジャックコネクタ	—
CLK OUT	エクスポートしたサンプルクロック、エクスポートした基準クロック	SMB ジャックコネクタ	—
DIGITAL DATA & CONTROL	デジタルデータチャンネル、エクスポートしたサンプルクロック、STROBE、イベント、トリガ	68 ピン、VHDCI コネクタ	—

CVI、LabVIEW、National Instruments、NI、ni.com、National Instruments のコーポレートロゴ及びイーグルロゴは、National Instruments Corporation の商標です。その他の National Instruments の商標については、ni.com/trademarks に掲載されている「Trademark Information」をご覧ください。The mark LabWindows is used under a license from Microsoft Corporation. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. 本文中に記載されたその他の製品名および企業名は、それぞれの企業の商標または商号です。National Instruments の製品 / 技術を保護する特許については、ソフトウェアで参照できる特許情報 (**ヘルパー特許情報**)、メディアに含まれている patents.txt ファイル、または「National Instruments Patent Notice」(ni.com/patents) のうち、該当するリソースから参照してください。